

证券代码：603800

证券简称：道森股份

苏州道森钻采设备股份有限公司

Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co., Ltd.

(注册地址：苏州市相城区太平镇)



2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

二〇二二年八月

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”或“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略，顺应国家政策趋势，实现公司战略转型，提升核心竞争力，公司拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）募集资金。公司董事会对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次发行的募集资金总额不超过人民币 148,800.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	电解铜箔高端成套装备制造项目（一期）	100,176.88	100,000.00
2	先进材料及高端装备研发中心建设项目	24,815.00	24,800.00
3	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
	合计	148,991.88	148,800.00

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额低于上述项目对募集资金的需求总额，不足部分由公司通过自筹方式解决。若本次发行募集资金的到位时间与上述项目的资金需求时间不一致，公司将根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）电解铜箔高端成套装备制造项目（一期）

1、项目概况

本次电解铜箔高端成套装备制造项目（一期）由控股子公司洪田科技实施，主要生产锂电铜箔高端生产装备产品。本项目拟通过引入先进的生产设备及数字化、信息化管理系统，新建电解铜箔高端生产装备产业化基地。本次募集资金项目将顺应行业发展趋势，满足下游市场日益增长的需求，有效解决公司产能不足、生产场地多处分散等限制，有利于提高电解铜箔高端生产装备的产能与产量，增强规模效应，提升盈利能力。

2、项目实施的必要性

(1) 顺应行业发展趋势，满足下游日益增长的市场需求

锂电铜箔作为锂电池负极材料集流体，受益于锂电池及其相关的新能源汽车、储能电池等锂电新能源产业长期可持续的需求，将实现持续高速增长。根据 GGII 统计数据，2021 年全球锂电铜箔出货量达 38.3 万吨，同比增长 70.2%，预计到 2025 年有望达 97.0 万吨，2020 年至 2025 年期间复合增速为 33.9%。2021 年我国锂电铜箔出货量为 24.0 万吨，同比增长 60.4%，预计到 2025 年有望达 75.4 万吨，2020 年至 2025 年期间复合增速为 38.2%。电子电路铜箔受全球 PCB 行业稳健增长的积极带动，近年来产量亦处于稳步提升状态，根据 GGII 数据，全球电子电路铜箔市场出货量从 2016 年的 34.6 万吨增长至 2021 年的 55.2 万吨，预计到 2025 年有望达 73 万吨，2020 年至 2025 年期间复合增速为 7.4%左右。根据 CCFA 及 GGII 统计数据，2021 年我国电子电路铜箔出货量为 39.6 万吨，同比增长 18.1%，预计到 2025 年达 48 万吨，未来呈现稳定增长的趋势。随着锂电铜箔及电子电路铜箔行业高速增长，亦将推动电解铜箔高端生产装备行业快速发展；加之全球电解铜箔高端生产装备供应严重不足，例如行业内电解铜箔制造企业购买日本阴极辊，其交付订单已排到 2026 年，国产设备替代进口空间巨大。因此，公司有必要扩大生产规模，满足电解铜箔行业，尤其是锂电铜箔行业日益增长的生产装备需求。

本次募集资金项目的实施，顺应行业发展趋势，有利于扩大锂电铜箔生产装备的生产规模，满足下游日益增长的市场需求，提升公司整体盈利能力。

(2) 解决生产场地租赁与多处分散限制，提升公司核心竞争力

洪田科技共租赁 7 处不同位置的厂房进行生产，其中 5 处位于南通市，2 处位于盐城市，由于生产场地多处分散且场地受限，经营管理存在诸多不便，而且由于生产规模迅速扩大以及生产基地周围可满足 300 吨承重要求的特殊构造厂房较为紧缺，长期使用存在不确定性，不利于公司电解铜箔高端生产装备的扩产。此外，洪田科技现有场地为通用厂房，与专用生产基地的规划布局存在较大差异，现有场地存在车间生产流程优化受限，导致生产效率较低、应急供货能力下降。为满足公司电解铜箔高端生产装备业务的发展需要，公司有必要自建专用厂房解决现有生产场地分散与生产流程优化问题。

本次募集资金项目的实施,有助于提升电解铜箔高端生产装备的产能与生产效率,巩固公司在国内电解铜箔设备,尤其是锂电铜箔生产装备领域的领先地位。

(3) 增强规模效应,提升公司盈利能力

对于生产制造业企业而言,在一定的条件下,生产规模的扩大,其管理费用、销售费用、部分固定资产折旧等固定成本并不会随之增加。因此,企业通过提升生产规模,发挥规模效应,能有效分摊固定成本,从而降低产品单位生产成本。洪田科技是国内领先的电解铜箔高端生产装备制造商,通过整合与扩大生产规模,有利于公司在电解铜箔装备制造领域形成规模化优势,提升盈利能力。此外,洪田科技生产所用贵金属钛材、大宗商品钢铁与铜材等原材料成本在生产成本中占比达 90%左右,采购规模较大,通过规模化优势有利于提升公司采购环节的议价能力,从而有效降低原材料的采购成本。

本项目的实施,将有助于公司发挥生产规模优势,增强对上游钛金属等原材料供应的议价能力,有效降低产品单位生产成本,从而提升公司盈利能力。

3、项目实施的可行性

(1) 锂电池和 PCB 行业广阔的市场前景,为本项目实施奠定市场基础

在锂电池领域,近年来,受化石能源依赖、全球气候变暖等能源环保问题的驱动,新能源汽车与储能电池行业呈现快速增长的趋势,从而带动锂电池市场快速发展。根据 GGII 数据,2021 年全球锂电池出货量达 543GWh,同比增长约 77.5%,预计到 2025 年,将达到 2,000GWh 左右,2021 年至 2025 年复合增长率超过 38%;2021 年我国锂电池出货量为 327GWh,同比增长 130%,预计到 2025 年,将达到 1,450GWh,2021 年至 2025 年复合增长率超 43%,从以上数据可看出,未来锂电铜箔行业出货量增速低于锂电池行业市场出货量增速,两者之间存在一定供需差,有利于促进上游铜箔生产装备行业进一步扩产以生产锂电铜箔,满足下游锂电池市场需求。在 PCB 领域,受消费电子、通讯设备等电子信息产业的蓬勃发展,PCB 行业呈现较为快速的增长趋势,未来依旧稳健增长。根据 Prismark 预测数据,2026 年全球 PCB 市场规模将达 1,016 亿美元,2021 年至 2026 年期间复合增速为 4.8%。随着全球 PCB 中高端产能逐步向我国转移,我国 PCB 行业增速高于全球

PCB 行业市场增速。锂电铜箔与电子电路铜箔分别广泛应用于锂电池和 PCB 两大下游行业，随着锂电池和 PCB 行业的快速增长，亦将带动上游锂电铜箔与电子电路生铜箔产装备行业的发展。近年来，受益于锂电新能源产业爆发性的市场需求，洪田科技业务增长势头良好，其主要产品锂电铜箔高端生产装备长期处于供不应求状态，在手订单充足。

综上所述，锂电铜箔与电子电路铜箔生产装备行业具有较好的市场前景，尤其是本次募集资金项目主要扩产的锂电铜箔生产装备将呈现快速增长趋势，市场前景广阔，为本次项目实施提供了良好的市场基础。

（2）丰富的客户资源及战略合作，为本项目产能消化提供坚实的保障

洪田科技作为国内领先的电解铜箔高端生产装备制造制造商，已积累丰富的客户资源，与国内外知名铜箔企业建立了密切的合作关系，其中国内上市公司客户有诺德股份、嘉元科技、中一科技、海亮股份、超华科技等，国企客户有金川集团、豫光金铅、江西耶兹等，海外客户有韩国日进、台湾南亚、台湾长春等，其它国内外知名客户还有新疆亿日、广东盈华、江西铜博等。经过多年发展，道森股份已建立成熟的网络营销体系，营销网络覆盖全球，客户覆盖全球近 20 个国家和地区，洪田科技可借助母公司全球化的营销经验，进一步完善营销体系，开拓国际市场。此外，为加强下游客户的深度合作，公司已与诺德股份等行业头部企业签订战略合作协议，双方有良好的上下游供需基础和产业技术一致性，可以实现产业协同、优势互补与合作共赢。

综上，公司丰富的客户资源及战略合作，为消化本次募集资金项目新增产能提供坚实的保障。

（3）先进的生产技术，为本项目实施提供有力保障

目前，洪田科技已成功研制出直径 3 米，幅宽 1.82 米的超大规格电解铜箔阴极辊、生箔机以及配套设备，能稳定生产高端极薄的锂电铜箔 3.5um 产品以及 5G 高频高速 9um 超薄电子电路铜箔产品，前述技术的创新突破，填补了国内外行业空白，也刷新了电解铜箔设备行业的新纪录；其次，洪田科技的阴极辊可实现行业最大工作电流，且槽内电压稳定在 5V 左右，在提高产能的同时减少能耗；另

外,收卷是电解铜箔生产环节的最后考验,是衡量设备性能的核心技术指标之一,越薄越难收卷,对于设备的加工精度要求非常高,洪田科技 6um 铜箔设备的收卷已突破 5 万米,收卷技术位居国内第一。凭借先进的生产技术优势,洪田科技先后荣获“高工金球奖 2020 年度创新技术”、“高工金球奖 2020 年度快速成长企业”等荣誉。此外,道森股份为传统油气能源设备制造商,在行业中有着先进的生产技术和先进的管理优势,现已建立成熟的生产管理体系,产品生产严格按照 ISO9001、APIQ1 质量管理体系控制。在生产管理方面,公司与洪田科技具有较强的协同关系,洪田科技可借鉴公司的生产标准,进一步完善生产管理体系,从而提升产品质量。

综上所述,公司在电解铜箔高端生产装备制造领域具备先进的生产技术,为本次募集资金项目顺利实施提供了有力保障。

4、项目实施主体

本项目的实施主体为洪田科技有限公司,系公司控股子公司。2022 年 5 月 31 日,洪田科技与盐城市大丰区自然资源和规划局签订合同编号 3209822022CR0037 的《国有建设用地使用权出让合同》,约定洪田科技受让坐落于开发区南翔路北侧、斗龙港河西侧地块,宗地面积为 102,089 平方米。

5、项目建设期和投资估算

本项目建设期为 3 年,计划总投资 100,176.88 万元,其中建设投资 56,521.88 万元、设备投资 25,592.00 万元、软件投资 3,336.00 万元、预备费用 4,272.00 万元、铺底流动资金 10,455.00 万元。

6、项目效益评价

本项目达产后,可实现年均营业收入 92,325.75 万元,年均净利润 20,758.42 万元,项目预期效益良好。

7、项目的批复文件

截至本预案公告日,电解铜箔高端成套装备制造项目(一期)涉及的项目备案、环评事项等手续正在推进办理中。

（二）先进材料及高端装备研发中心建设项目

1、项目概况

本次先进材料及高端装备研发中心建设项目由道森股份实施。本项目拟通过购买研发场地、配置先进的研发设备，引进优秀的高端装备制造技术人才，建成集研发、技术孵化、技术交流、人才培养为一体的研发基地。本次募集资金项目主要研发方向如下：

（1）阳极板表面材料研发项目：通过对国内外阳极板取样分析，然后在 TA1 板材中添加其它类金属元素，得到高硬度、高均匀性、抗氧化性强的阳极板涂层，从而保证电解铜箔生产过程中间距稳定性以及生产出高均匀性的电解铜箔产品；

（2）复合铜箔生产设备研发项目：围绕解决制备超薄铜箔时存在撕边、收卷、皱褶等问题，采用载体铜箔与超薄铜箔复合制造方式，研发出一种超薄电解铜箔生产设备，打破复合薄铜箔被外企垄断的局面；

（3）多孔铜箔生产设备研发项目：重点研发在阴极表面布装绝缘材料，最终形成孔径和孔密度一致的绝缘点，满足高密度、微米级且表面光滑的微孔铜箔生产装备；

（4）真空镀膜设备研发项目：围绕解决在极薄的薄膜上镀铜出现变形、穿孔、均匀低等问题，研制出专用设备，使得非金属材料金属化，为最终得到复合型铜箔产品打下基础；

（5）锂电池涂布设备研发项目：通过对国内外主流涂布机使用情况汇总，对各类涂布设备的结构、环境影响因素、过程影响因素以及弊病关联情况进行分析，开发一种高精密的涂布设备，解决现有涂布机在张紧力变化使得集流体经过背辊时出现褶皱，影响涂覆均匀性的问题。

2、项目实施的必要性

（1）顺应下游市场发展趋势，满足下游客户对新技术、新装备的市场需求

在锂电池领域，锂电铜箔是其关键材料，对锂电池的比容量、安全性、稳定性、循环寿命和生产成本等主要指标起到关键作用。随着锂电池技术不断提升，

对锂电铜箔质量的稳定和性能也提出更高的要求。本次募集资金项目通过开展复合铜箔生产设备、多孔铜箔生产设备和真空镀膜生产设备研发，开发能够生产高密度、微米级的新型电解铜箔生产设备，从而提升锂电池的能量密度、安全稳定性、循环寿命，拓宽电解铜箔在锂电新能源产业中的应用范围；另外，借助公司在锂电铜箔生产装备领域的研发积累，对锂电池涂布机生产设备技术攻关，开发能够生产高精密、高稳定性的涂布机设备，解决极薄锂电铜箔在涂布机易褶皱、断裂等技术难题，加速极薄锂电铜箔从 6um 到 4.5um 再到 3.5um 的深度应用，不断提升锂电池容量和安全稳定性，丰富公司锂电池生产装备品种结构。

在 PCB 领域，近年来，随着电子技术的快速发展，推动 PCB 向高密度化、轻薄化和多功能化方向发展，超薄铜箔的研发、制造和应用等已逐渐展开。随着下游应用行业对高性能、高品质、高可靠性电子电路铜箔的市场需求高速增长，亦对上游电子电路铜箔生产装备企业的设计及工艺优化技术提出了更高要求。本次募集资金项目通过开展复合铜箔生产设备研发，开发能够生产高均匀性的超薄铜箔生产设备，从而满足 PCB 行业向轻薄化、多功能化、高性能化的市场需求。

在电解铜箔阳极板领域，阳极板属于一种生产耗材，是电解铜箔生产设备生箔机的重要配件，由于其更换频次、单价较高，具有相当的市场规模。根据测算数据，2021 年全球电解铜箔阳极板耗材规模已达 31 亿元左右，预计到 2025 年将达到 65 亿元左右。本次募集资金项目通过开展阳极板表面材料研发，在钛板材中添加其它元素，研制出一种高均匀性、高硬度的新型材料阳极板，以满足阳极板耗材的市场需求。

（2）优化研发资源配置，提升研发实力

公司以市场需求为导向，以服务客户为驱动，坚持研发投入，利用包括自主研发、市场合作研发、校企产业研发等多种研发模式，不断积累和发展自主知识产权。近年来，公司积极开拓新行业、新市场，并通过收购洪田科技的方式快速切入行业前景良好的新能源生产装备行业，实现迅速战略转型。随着公司原有业务以及新业务研发项目不断增加，现有的研发场地、设备条件、实验环境、人才储备已难以满足未来需求。因此，公司亟需配置先进的研发设备、仪器，引进优秀高端技术人才，搭建高标准的研究平台。本次募集资金项目的实施，有利

于公司形成从核心基础技术到产品应用技术相结合的研究开发体系，这不仅是满足新产品研发和生产工艺技术改进的需要，更是适应公司快速发展，实现公司战略的必由之路。

（3）优化公司产品结构，加快电解铜箔高端生产装备的进口替代

随着锂电新能源产业以及电子信息产业的快速发展，我国电解铜箔高端生产装备行业拥有良好的市场前景。经过多年发展，洪田科技已掌握电解铜箔高端生产装备核心技术，现有产品已能稳定生产高端极薄的锂电铜箔以及 5G 高频高速超薄电子电路铜箔。基于洪田科技研发技术积累，公司将进一步加大研发投入，研发出更多高性能、高品质的电解铜箔高端生产装备，满足高端市场需求，扩大公司在电解铜箔高端生产装备领域的市场份额，丰富与优化公司现有电解铜箔高端生产装备的产品结构，为公司未来可持续发展打下坚实基础。

此外，在电解铜箔高端生产装备领域，国内近十年呈现快速发展趋势，国产化率已相对较高，但与国外领先技术相比还有一定差距，部分客户在选择电解铜箔高端生产装备时仍然以日本进口为主。公司作为专业从事电解铜箔高端生产装备的高新技术企业，将紧密围绕市场需求，加大在电解铜箔高端生产装备的研发投入，对于加快国产电解铜箔高端生产装备的进口替代具有重要意义。

（4）打造集研发、技术孵化、技术交流、人才培养为一体的研发基地，增强产业转化能力与培养行业技术人才

未来随着电解铜箔朝着厚度薄、强度高、表面粗糙度低、延展性好、高抗拉强度等方向发展，对生产设备的稳定性以及精密性也将越来越严格。为全面、深入地满足市场高阶化需求，增强产业转化能力，巩固公司在行业中的市场地位，公司有必要加大在电解铜箔高端生产装备领域新产品与新技术的研发力度，从而巩固公司在行业中的市场地位。

本次募集资金项目拟通过购买研发场地以及购置相应的研发设备和设施，建成一个集研发与服务功能为一体的研发基地，推动公司在电解铜箔高端生产装备相关领域的研发工作。本次项目实施完成后，建成的研发基地将为国内外相关行业提供必要的技术咨询及综合技术服务，接受国内有关企业和科研机构委托的工

程技术研究、试验和成套技术服务；同时研发基地将通过加强国际交流与合作，进行产业技术孵化，为行业技术成果的转化提供良好的支持与服务；此外，研发基地还将成为人才培训基地，对企业生产技术人员进行培训，提高其生产、管理方面的专业技能，为省内外高校、科研院所、企事业单位的相关人才提供研究、进修、就业、见习的实验基地，为本领域培养更多的优秀专业技术人才，满足公司及行业快速发展的人才需求。

3、项目实施的可行性

(1) 公司具备强大的技术研发实力，为本项目实施提供可靠的技术保障

自成立以来，公司一直注重先进技术的自主研发，通过与全球顶尖的油气能源生产设备企业的技术交流合作，引进和积累了大量的先进技术及工艺，在锻造、焊接、热处理、精密加工制造、表面处理等工艺技术处于行业前列。在电解铜箔高端生产装备制造领域，洪田科技拥有专业的自主研发团队，经过多年的发展，洪田科技已积累多项核心技术，在研直径 3.6 米超大规格电解铜箔阴极辊、生箔机以及配套设备，能稳定生产高端极薄的锂电铜箔 3um 产品。此外，洪田科技生产技术与公司在锻造、焊接、热处理、精密加工制造、表面处理等工艺技术具有一致性。公司在装备制造领域雄厚的技术沉淀以及先进的技术研究中心将为洪田科技技术研发进一步赋能、产生协同效应，提升其在电解铜箔生产领域的技术研发实力。凭借领先国内的油气能源设备与电解铜箔高端生产装备核心技术与生产工艺，公司被授予或设立江苏省博士后科研工作站、苏州市企业院士工作站、江苏省工程技术研究中心、苏州市企业技术中心、长江大学研究生实践基地。截至本预案公告日，公司累计共获得 223 项专利授权，其中 18 项发明专利。

综上，公司在装备制造领域具有较强的自主研发实力，为本项目顺利实施提供可靠的技术保障。

(2) 公司在装备制造领域的人才资源优势，为本项目实施奠定坚实基础

公司在装备制造领域人才资源优势较为明显。在油气能源生产设备制造领域，为保持竞争优势及行业市场地位，经过多年培养和积累，公司已拥有一批经验丰富的专业技术研发人才及管理经验丰富的复合型人才，专业领域涵盖从锻造、热

处理、特种焊接、机加工到总装测试的完整装备制造产业链。在电解铜箔高端生产装备制造领域，洪田科技已建立研发中心，以日本松田光也先生（中文名：云光义）为代表的核心技术团队，对于电解铜箔高端生产装备有着深刻认识，市场敏锐度高，拥有领先同行业的技术创新能力；洪田科技创始人松田光也先生自公司创立以来全面负责公司生产与研发工作，先后申请各类专利近 20 项，主导产品入选高工锂电创新技术奖。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共有研发人员 160 人，占公司员工总人数比重超过 10%。

（3）公司具有完善的研发管理制度，为本项目顺利实施奠定制度基础

为提高创新能力，加强新技术、新产品、新工艺的研究开发和技术积累，公司已建立规范的科研管理、监督体系及质量保证体系，明确落实各职能科室的研究方向、课题，明确工作职责和目标；已制定行之有效的绩效考核与激励机制，奖励在技术、工艺、设备方面取得研究成果及发明专利人员，对研发部门人员进行定期考核，优胜劣汰；合理使用科研经费，并加大对思维创新、技术创新投入与奖励力度。在电解铜箔高端生产装备制造领域，洪田科技一直注重研发项目管理与制度建设，积极学习和借鉴日本及国内高端装备制造领域各种前沿技术研发成果，认真抓好项目研发相关环节，促进生产从数量型向质量型转变，建立了一系列研发管理相关制度，主要包括技术管理制度、质量管理制度、生产管理制度以及工作环节的工艺流程等。

综上所述，公司在研发体系设置、研发流程管理上均具备丰富的经验，并形成了成熟的管理体系，有利于公司保持持续的创新活力，为本项目的成功实施提供研发制度基础。

4、项目实施主体

本项目的实施主体为苏州道森钻采设备股份有限公司。

5、项目建设期和投资估算

本项目建设期为 3 年，计划总投资 24,815.00 万元，其中包含研发场地投资 6,000.00 万元、研发场地装修费 1,476.00 万元、设备投资 11,524.00 万元、研发费用 5,815.00 万元。

6、项目效益评价

本项目为研发中心建设，不形成新增产能，故未进行效益测算。

7、项目的批复文件

截至本预案公告日，先进材料及高端装备研发中心建设项目涉及的项目备案、环评事项等手续正在推进办理中。

（三）补充流动资金

1、项目概况

本次非公开发行股票募集资金中 24,000 万元用于补充流动资金。

2、项目实施的必要性

（1）进一步优化资本结构，提高公司偿债能力。2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，公司资产负债率分别为 42.42%、42.48%、50.77%和 69.82%，流动比率分别为 1.86、1.85、1.63 和 1.13，速动比率分别为 1.47、1.27、1.13 和 0.69，长期与短期偿债能力指标均有所下降，相对同行业上市公司平均水平，公司资本结构尚有优化空间。同时，公司长期借款与短期借款金额接近 4 亿元，有一定的还款压力。综上，公司存在进一步优化资本结构，提高偿债能力的需求。通过本次非公开发行项目补充流动资金，有利于降低公司的资产负债率、提高公司偿债能力及资金实力，缓解公司因资金需求而实施债务融资的压力，从而优化公司财务结构，增强公司抗风险能力。

（2）满足流动资金需求，抓住主营业务战略转型发展机遇。2022 年 6 月，公司通过收购洪田科技完成电解铜箔高端生产装备四大工序核心产品、行业领先的技术工艺、优质的客户群体布局，实现了从传统油气能源设备制造商向新能源高端装备制造制造商的战略转型。当前，国内外锂电新能源产业发展迅速、市场前景广阔，洪田科技对公司的战略价值极为明显，如能抓住行业发展新机遇，继续完善全球产业链布局，将有利于公司主营业务优化提升的成效进一步显现。公司目前处于主营业务发展的重要节点，外部有行业发展的重要机遇，内部有进一步优化油气能源与锂电新能源生产制造业务、完善全球产业链布局的需求，需要流动

资金支持主营业务持续发展。公司拟将本次非公开发行募集资金用于补充流动资金，满足公司主营业务发展相关的流动资金需求，为主营业务持续平稳、健康发展提供有力保障。

(3) 业务规模快速增长需要较大规模的流动资金支撑。公司产品为根据客户需求进行设计和开发的传统油气能源设备和新能源高端生产装备，从购买原材料到产品装配、调试、验收及收回货款的资金循环周期较长。随着业务规模和营业收入的不断增长，公司对营运资金的需求也随之扩大。公司充分考虑业务发展扩张所面临的流动资金压力，兼顾主营业务的延伸，为健康、稳定发展夯实基础，巩固公司主营业务，从而提升公司的核心竞争力。

三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次非公开发行募集资金扣除发行相关费用后将用于电解铜箔高端成套装备制造项目（一期）、先进材料及高端装备研发中心建设项目和补充流动资金，募集资金投向与公司发展战略、经营目标相一致，有助于公司由传统油气能源设备制造商向新能源高端装备制造制造商的迅速转型。本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系说明如下：

1、本次募集资金电解铜箔高端成套装备制造项目（一期）的建成，将大幅提高公司电解铜箔尤其是锂电铜箔高端生产装备的产业化生产能力、解决生产经营场分散、生产流程优化受限的现状，提高公司在锂电铜箔高端生产装备的市场份额。

2、本次募集资金先进材料及高端装备研发中心建设项目将大幅提高公司的持续创新能力，满足下游客户对新材料、新技术、新装备的市场需求，从而巩固并增强公司在电解铜箔高端装备制造领域的市场领先地位，提升公司的整体竞争力。

3、本次募集资金补充流动资金项目，可为公司实现业务发展目标提供充足的资金来源，有效弥补油气能源设备与新能源高端装备制造业务规模扩张持续增加的营运资金缺口，更好地满足公司生产、运营的日常资金周转需要，改善公司财务状况，优化资本结构，有利于公司未来在行业内持续稳健发展。

四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策和公司战略转型发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金投资项目的实施具有必要性与可行性，符合公司及全体股东的利益。项目完成后，能够进一步提升公司的核心竞争力，提高公司盈利水平、研发能力和抵御风险能力，增加利润增长点。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将有所增加，能够进一步提高公司抗风险的能力，为公司未来的发展奠定基础。

本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅度增加；在资金开始投入募投项目后，投资活动产生的现金流出将有所增加；在募投项目建成运营后，公司经营活动产生的现金流量净额预计将得到提升。

本次发行完成后，公司股本总额将即时增加，但募集资金投资项目产生效益需要一定时间，因此，公司的每股收益短期内存在被摊薄的风险。本次募集资金投资项目的实施有利于提高公司的主营业务收入与利润规模，提升公司综合实力和核心竞争力。

五、结论

综上所述，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司整体发展战略，具有良好的经济效益和社会效益，对公司盈利增长和持续发展具有重要意义。项目顺利实施后将进一步提升公司在高端装备制造领域的综合竞争实力，提升公司盈利水平，增强公司核心竞争力。董事会认为，本次募集资金投资项目，风险可控，未来预期收益良好，具有必要性和可行性。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022年8月22日